МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наклонная ионная имплантация

Практикум к спецкурсу "Моделирование в микроэлектронике" по специальности 014100 "Микроэлектроника и полупроводниковые приборы"

Воронеж 2003 Утвержден научно-методическим советом физического факультета от 9 января 2003 г.

Составители: Бормонтов Е.Н Быкадорова Г.В. Григорьев Р.Г. Науч. ред. Петров Б.К.

Практикум подготовлен на кафедре физики полупроводников микроэлектроники Воронежского государственного университета.

Рекомендуется для студентов 4 и 5 курсов физического факультета специальности 014100 "Микроэлектроника и полупроводниковые приборы", а также студентов 6 курса, обучающихся в магистратуре по направлению "Физика" (программа "Физика полупроводников. Микроэлектроника").

Содержание

Введение	4
1. Распределения ионно-имплантированных примесей при наклонной имплантации	5
2. Локальная наклонная имплантация	12
2.1. Распределение примесей при наклонной имплантации с учетом бокового рассеяния под край защитной маски	12
2.2. Распределение примесей при наклонной имплантации с учетом бокового рассеяния под края щели в защитной маске	23
Литература	29
Приложение. Аппроксимирующие полиномы для расчета параметров распределений основных примесей в кремнии	30

Введение

Постоянная сверхбольших минимизация элементов В современных необходимости формирования интегральных схемах приводит к мелкозалегающих легированных слоев с субмикронными размерами. В важных ДЛЯ практических применений случаях максимум концентрации ионноимплантированной примеси должен находиться в пределах 5÷10 нм OT поверхности подложки. Такое распределение имплантированной примеси может быть достигнуто лишь применением низкоэнергетических ионных пучков с энергией менее нескольких килоэлектронвольт. Однако большинство технологических установок не в состоянии обеспечить стабильные пучки столь низких энергий. В последнее время для формирования мелкозалегающих слоев используется ионная имплантация наклонными пучками, которая позволяет получить необходимое распределение имплантированной примеси В энергетическом диапазоне, доступном для современных ускорителей [2,5].

Применение наклонных пучков может достаточно сильно повлиять на боковое распределение примеси. Для современных сверхбольших интегральных схем с высокой плотностью приборов на кристалле необходимость рассмотрения подобного рода двумерных эффектов имеет принципиальное значение [4,5], поскольку измерение двумерного распределения концентрации имплантированной примеси в мелкозалегающих слоях является очень сложной практической задачей. Поэтому теоретические исследования и математическое моделирование приобретают в этом случае особую важность.

Так, при создании методом наклонной имплантации истоковых и стоковых областей современных МОП транзисторов теневой эффект приводит к различию распределения концентрации примеси в истоковых и стоковых областях [3,4]. Вследствие этого возникает асимметрия и рассогласование электрических характеристик субмикронных МОП транзисторов при работе в прямом и обратном включении. Степень асимметрии и рассогласования характеристик МОП транзисторов снижается при имплантации с поворотом подложек последовательно на 90° с 25%-ной дозой имплантации в каждом из четырех положений [3].

Столь актуальные в технологии современной микро- и наноэлектроники вопросы математического моделирования наклонной имплантации практически не рассмотрены в существующей учебно-методической литературе, поэтому данные методические указания помогут студентам в освоении рассматриваемой темы.

1. Распределения ионно-имплантированных примесей при наклонной имплантации

При внедрении ускоренных ионов в полубесконечную подложку под углом q к нормали максимум распределения смещается к поверхности. При этом в значение среднеквадратичного отклонения *DR* вносит вклад как продольное среднеквадратичное отклонение *DR_p*, так и среднеквадратичное поперечное отклонение *DR_s* [1]. В результате распределение примеси *N*(*x*) по нормали к поверхности при наклонной имплантации имеет вид:

- в случае неусеченной гауссианы, когда R_p ³*D* R_p ,

$$N(x) = \frac{Q}{\sqrt{2p}\Delta R} \cdot e^{-\frac{(x-R_p\cos q)^2}{2\Delta R^2}};$$
(1.1)

0

- в случае усеченной гауссианы, когда $R_p < 3DR_p$,

$$N(x) = \frac{Q}{\sqrt{\frac{p}{2}}\Delta R \left(1 + erf \frac{R_p \cos q}{\sqrt{2}\Delta R}\right)} \cdot e^{-\frac{(x - R_p \cos q)^2}{2\Delta R^2}},$$
(1.2)

где $\Delta R^2 = \Delta R_p^2 \cos^2 q + \frac{1}{2} \Delta R_\perp^2 \sin^2 q$;

Q - доза имплантации;

$$erf(z) = \frac{2}{\sqrt{p}} \int_{0}^{z} e^{-z^{2}} dz$$
 - интеграл функции ошибок Гаусса.

Если исходная подложка легирована примесью противоположного типа с исходной концентрацией N_{ucx} , то возможно формирование одного или двух p-n переходов (рис.1), глубины $x_{j1,2}$ залегания которых находятся из условия $N(x_{j1,2})-N_{ucx}=0$.

Для случая неусеченной гауссианы при наклонной имплантации глубины залегания p-n переходов рассчитываются по формуле

$$x_{j1,2} = R_p \cos q \pm \Delta R_{\sqrt{2 \ln \frac{Q}{\sqrt{2p} \Delta R N_{ucx}}}} \qquad (1.3)$$



Рис. 1. Распределения ионно-имплантированной примеси по глубине х в случае образования одного p-n перехода (б) и двух p-n переходов (а)

Задания

 Проводится наклонная имплантация ионов фосфора в подложку кремния марки КДБ2. Энергия ионов составляет 60 кэВ, доза имплантации – 10¹² ион/см², а угол наклона пучка ионов относительно нормали равен 20°. Рассчитать концентрационный профиль распределения ионов фосфора и построить график полученного профиля в координатах N(x)-x.

Решение

Концентрация исходной примеси N_{ucx} в данной кремниевой подложке оценивается по удельному сопротивлению $r = 2 \ O_M \cdot c_M$ и подвижности дырок при данной температуре $m_p = 500 \ c_M^2 / (B \cdot c)$:

$$N_{ucx} = \frac{1}{rm_{p}q} = \frac{1}{2 \cdot 500 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}} = 6.25 \cdot 10^{15} cm^{-3}.$$

По энергии ионов с помощью аппроксимирующих полиномов, приведенных в приложении, рассчитываются параметры распределения ионов фосфора в кремнии, которые при энергии 60 кэВ составили следующие значения:

$$R_p = 7.31 \cdot 10^{-6} c_{\mathcal{M}}; \ \Delta R_p = 3.0 \cdot 10^{-6} c_{\mathcal{M}}; \ \Delta R_{\perp} = 2.25 \cdot 10^{-6} c_{\mathcal{M}}.$$

Расчет концентрационного профиля будет проводиться для усеченной гауссианы, поскольку $7.31 \cdot 10^{-6}$ см $\leq 3 \cdot 3.3 \cdot 10^{-6}$ см.

Максимальная глубина x_{max} , на которую рассчитывается концентрационный профиль, должна превышать глубину залегания второго p-n перехода x_{j2} : $x_{max} = x_{j2} + \Delta R$.

Задав число точек по координате х, в которых будут рассчитываться значения концентрации, например 20, получим шаг *h*: *h*=*x_{max}/20.* Для решения данной задачи составлена программа на языке Паскаль.

```
program Nakl;
const pi=3.1415926; eq=1.6e-19;
var N,x:array [0..200] of double:
    q,e,Rp,dRp1,dRp2,dR,tetta,xj1,xj2:double;
    econs,Nmax,Nicx,ro,mu,xmax,h:double;
    j,j1:integer; o,tip:char;
function lg(z:double):double;
  begin lg:=ln(z)/2.3; end;
function Rpp(E1:double):double;
     var lgRp:double; i:integer;
       a:array[0..3] of double;
     begin
      E1:=ln(lg(E1)); lgRp:=0.0;
      a[0]:=0.682; a[1]:=0.1861; a[2]:=0.3769; a[3]:=-0.0581;
      for i:=0 to 3 do lgRp:=lgRp+a[i]*exp(i*E1);
      Rpp:=exp(2.3*lgRp)*1e-7;
    end:
function dRpp1(E1:double):double;
     var lgRp:double; i:integer;
       a:array[0..3] of double;
     begin
      E1:=ln(lg(E1)); lgRp:=0.0;
      a[0]:=0.401; a[1]:=0.2209; a[2]:=0.3478; a[3]:=-0.0711;
      for i:=0 to 3 do lgRp:=lgRp+a[i]*exp(i*E1);
      dRpp1:=exp(2.3*lgRp)*1e-7;
    end:
function dRpp2(E1:double):double;
     var lgRp:double; i:integer;
       a:array[0..3] of double;
     begin
      E1:=ln(lg(E1)); lgRp:=0.0;
      a[0]:=0.205; a[1]:=0.537; a[2]:=0.051; a[3]:=0.015;
      for i:=0 to 3 do lgRp:=lgRp+a[i]*exp(i*E1);
      dRpp2:=exp(2.3*lgRp)*1e-7;
    end;
function erf(z:double):double;
var s,sx:double; j2:integer;
   begin
    sx:=z;s:=z;j2:=1;
    repeat
    sx:=-sx*z/(2*j2+1)*z/j2*(2*j2-1);
```

```
s:=s+sx; j2:=j2+1
    until abs(sx)<1e-10;
    erf:=s*2/sqrt(3.141592653589);
    end:
begin
writeln(' '); write('Исходная подложка: тип (n) или (p)? '); readln (tip);
if tip='n' then mu:=1400 else mu:=500;
write('
       ,удельное сопротивление в Ом*см? '); readln(ro);
Nicx:=1/(ro*eq*mu);
write(' ,энергия в кэВ ? '); readln(e);
Rp:=Rpp(e);
dRp1:=dRpp1(e); dRp2:=dRpp2(e);
write(' ,доза в ион/см2 '); readln(q);
write(' угол падения ионов в градусах? '); readln(tetta); tetta:=tetta*pi/180;
dR:=dRp1*dRp1*cos(tetta)*cos(tetta);
dR:=dR+dRp2*dRp2*sin(tetta)*sin(tetta)/2; dR:=sqrt(dR);
i1:=20;
if Rp>=3*dRp1 then begin
 xj2:=Rp*cos(tetta)+dR*sqrt(2*ln(q/(sqrt(2*pi)*dR*Nicx)));
 xmax:=xj2+dR;
 h:=xmax/j1; Nmax:=q/(sqrt(2*pi)*dR);
 for j:=0 to j1 do
 begin
  x[i]:=h*i;
  econs:=x[j]-Rp*cos(tetta);
  N[j]:=Nmax*exp(-econs*econs/(2*dR1*dR1))-Nicx;
  writeln(x[j]*1e4:7:3,' mkm ',' ',N[j]:10,' cm-3 ');
 end;
end
else begin
 Nmax:= q/(sqrt(pi/2)*dR);
 Nmax:=Nmax/(1+erf(Rp*cos(tetta)/(sqrt(2)*dR)));
 xj2:=Rp*cos(tetta)+dR*sqrt(2*ln(Nmax/Nicx));
 xmax:=xj2+dR;
 h:=xmax/j1;
 for j:=0 to j1 do
 begin
  x[j]:=h*j;
  econs:=x[j]-Rp*cos(tetta);
  N[j]:=Nmax*exp(-econs*econs/(2*dR*dR))-Nicx;
  writeln(x[j]*1e4:7:3,' mkm ',' ',N[j]:10,' cm-3 ');
 end;
end;
readln(o)
end.
```

х,мкм	N,см ⁻³	х,мкм	N,см ⁻³
0	1.9E+15	0.096	8.8E+16
0.009	9.3E+15	0.105	6.4E+16
0.017	2.1E+16	0.114	4.2E+16
0.026	3.8E+16	0.122	2.4E+16
0.035	5.9E+16	0.131	1.1E+16
0.044	8.3E+16	0.14	3.1E+15
0.052	1E+17	0.149	-1.7E+15
0.061	1.2E+17	0.157	-4.2E+15
0.07	1.2E+17	0.166	-5.4E+15
0.079	1.2E+17	0.175	-5.9E+15
	0.087	1E+17	

В результате вычислений по данной программе получены следующие результаты:

Данная задача эффективно решается средствами MathCAD 2000. Ниже приведен листинг решения задачи на Mathcad 2000 и график распределения суммарной концентрации фосфора и исходной примеси в подложке (рис.2).

$$qe := 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \text{Kul} \quad \text{Kul} = \text{A} \cdot \text{sec} \qquad \theta := 20 \cdot \frac{\pi}{180} \qquad \text{Q} := 10^{12} \text{cm}^{-2}$$

$$Rp := 7.31 \cdot 10^{-6} \text{cm} \quad \Delta Rp := 3.0 \cdot 10^{-6} \text{cm} \qquad \Delta Rt := 2.55 \cdot 10^{-6} \text{cm}$$

$$\Delta R := \sqrt{\Delta Rp^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2}\Delta Rt^2 \cdot \sin(\theta)^2}$$

$$Xm := Rp + 4 \cdot \Delta Rp$$

$$Ni := \frac{1}{qe \cdot 500 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{sec}} \cdot 2 \cdot \text{ohm} \cdot \text{cm}}$$

$$N(x) := \frac{Q}{\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \Delta R \cdot \left(1 + \text{erf}\left(Rp \cdot \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2}\Delta R}\right)\right)} \cdot e^{-\frac{(x - Rp \cdot \cos(\theta))^2}{2 \cdot \Delta R^2}}$$

$$Nf(x) := |N(x) - Ni|$$



Рис.2. График распределения фосфора, внедренного в кремниевую подложку марки КДБ2 с энергией 60 кэВ и дозой 10¹² ион/см² под углом 20° относительно нормали к поверхности подложки

- 2. Рассчитать и построить график распределения по глубине примеси бора, внедренной в кремниевую пластину n-типа с исходной концентрацией 1.2·10¹⁴ см⁻³, в случае наклонной имплантации под углом 10° к нормали при энергии ионов бора 100 кэВ и дозе 85 мкКл/см². Определить глубину залегания сформированного p-n перехода.
- 3. Рассчитать и построить график распределения по глубине примеси бора, внедренного в кремниевую пластину n-типа с исходной концентрацией $1.2 \cdot 10^{14}$ см⁻³, в случае наклонной имплантации ионов фторида бора BF₂⁺ под углом 20° к нормали при энергии 100 кэВ и дозе 85 мкКл/см². Сравнить полученный концентрационный профиль с распределением, рассчитанным в задании 3 данного раздела. Изменится ли максимальная концентрация в примесном слое и координата её залегания? Сместится ли глубина залегания сформированного p-n перехода и на сколько процентов по отношению к глубине залегания p-n перехода, сформированного в условиях задания 3?
- 4. Проводится внедрение бора методом ионной имплантации в пластину кремния с целью создания примесного слоя с максимальной концентрацией 10¹⁸ см⁻³ и глубиной залегания p-n перехода 0.4 мкм. Найти необходимую энергию ионов бора и дозу при нормальной имплантации и определить угол наклона

внедряемых ионов бора относительно нормали, если необходимо уменьшить глубину залегания p-n перехода в полтора раза.

- 5. Исследовать зависимость глубины залегания p-n перехода от угла падения относительно нормали при наклонной имплантации ионами сурьмы с энергией 120 кэВ и дозой 100 мкКл/см² кремниевой подложки марки КДБ2.
- 6. Пластина кремния р-типа с исходной концентрацией 1.5·10¹⁴ см⁻³ легируется методом наклонной имплантации ионами фосфора в два этапа. На первом этапе угол наклона ионного потока с нормалью составляет 15°, а энергия и доза имплантации соответственно равны 80 кэВ и 200 мкКл/см². На втором этапе энергия ионов фосфора равна 50 кэВ, доза имплантации 150 мкКл/см², а угол наклона составляет 40°. Найти суммарное распределение внедренной и исходной примесей и определить глубину залегания сформированного p-n перехода.
- 7. Пластина кремния марки КДБ7 имплантируется ионами мышьяка с дозой 5·10¹⁴ см⁻² и углом наклона относительно нормали 10°. Энергия внедряемых ионов мышьяка 100 кэВ задается с погрешностью ±10%. Рассчитать статистический разброс глубин залегания максимума концентрации примесного слоя и сформированного p-n перехода по формулам:

$$\frac{\left|x_{\max} - x_{\max 10}\right|}{x_{\max 0}} \cdot 100\%;$$
$$\frac{\left|x_{j0} - x_{j10}\right|}{x_{j0}} \cdot 100\%,$$

где x_{max} , x_{max10} – глубины залегания максимума концентрации соответственно при 100 кэВ и (100±10) кэВ; x_{j0} , x_{j10} – глубины залегания p-n переходов соответственно при 100 кэВ и (100±10) кэВ.

Вопросы

- 1. Записать неусеченное гауссовское распределение примеси при наклонной имплантации в случае легирования изотипной подложки с исходной концентрацией *N*_{ucx}.
- 2. Записать усеченное гауссовское распределение примеси при наклонной имплантации в случае легирования изотипной подложки с исходной концентрацией N_{ucx} .
- 3. Вывести формулы для расчета максимальной концентрации и определения координаты максимума распределения при наклонной имплантации для случая неусеченной гауссианы.
- 4. Вывести формулы для расчета максимальной концентрации и определения координаты максимума распределения при наклонной имплантации для случая усеченной гауссианы.
- 5. Вывести формулу для расчета глубин залегания p-n переходов при наклонной имплантации в случае усеченной гауссианы.

- 6. Записать распределение примеси при наклонной имплантации для случая неусеченной гауссианы с учетом эффекта каналирования.
- 7. Записать распределение примеси при наклонной имплантации для случая усеченной гауссианы с учетом эффекта каналирования.

2. Локальная наклонная имплантация

2.1. Распределение примесей при наклонной имплантации с учетом бокового рассеяния под край защитной маски

При наклонной имплантации вблизи края защитной маски толщиной d $(d>>R_p+3DR_p)$ в зависимости от ориентации пучка ионов и его угла отклонения от нормали могут быть два случая: имплантация под край защитной маски (рис. 3,а) и имплантация с образованием теневого участка у края защитной маски (рис. 3,б) [1].

В обоих случаях при наклонной имплантации под углом q относительно нормали к поверхности распределение ионно-имплантированных примесей по глубине N(x) описывается неусеченной (1.1) или усеченной (1.2) гауссианами.

На заданной глубине *x* перераспределение ионно-имплантированных примесей за счет бокового рассеяния будет описываться по модели диффузии в неограниченное тело из полубесконечного пространства:

- при имплантации под край защитной маски

$$N(x, y) = \frac{N(x)}{2} \operatorname{erfc} \frac{y - a'}{\sqrt{2}\Delta R'_{\perp}} ; \qquad (2.1)$$

- при имплантации с образованием теневого участка у края защитной маски

$$N(x, y) = \frac{N(x)}{2} erfc \frac{a'' - y}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}'} = \frac{N(x)}{2} (2 - erfc \frac{y - a''}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}'}).$$
(2.2)





- Рис. 3. Формирование нормированных боковых профилей распределения наклонно имплантированных примесей:
- а) имплантация под край защитной маски;
- б) имплантация с образованием теневого участка у края защитной маски

В формулах (2.1) и (2.2) из геометрических соображений имеем

$$\Delta R'_{\perp} = \Delta R_{\perp} \sin q; a' = x \cdot tgq; a'' = (x+d)tgq.$$

В случае легирования подложки с противоположным типом проводимости и исходной концентрацией примеси N_{ucx} из условия $N(x_{j1,2}, y) = N_{ucx}$ можно получить аналитическую зависимость глубин залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов.

Например, если наклонно имплантируемый профиль описывается по глубине неусеченной гауссианой (1.1), а имплантация проводится под край защитной маски, то распределение у края защитной маски будет иметь вид

$$N(x) = \frac{Q}{2\sqrt{2p}\Delta R} e^{-\frac{(x-R_p\cos q)^2}{2\Delta R^2}} \operatorname{erfc}\frac{y-a'}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}'},$$
(2.3)

а зависимость $x_{jl,2}(y)$ глубины залегания сформированных p-n переходов есть функция

$$x_{j1,2}(y) = R_p \cos q \pm \Delta R_{\gamma} \sqrt{2 \ln \frac{Q \cdot erfc \frac{y-a'}{\sqrt{2\Delta R_{\perp}}}}{2\sqrt{2p} \Delta R N_{ucx}}}$$
 (2.4)

Задания

- 1. На кремниевую пластину р-типа с удельным сопротивлением 2 Ом см наносится защитный слой окисла толщиной 4 мкм, в котором травлением создается щель шириной 100 мкм. Наклонная имплантация бора проводится под край защитной маски под углом 10° относительно нормали к кремниевой пластине при энергии 50 кэВ и дозе 150 мкКл/см²:
 - а) рассчитать и построить график распределения нормированного бокового концентрационного профиля *N*(*x*=*const*, *y*)/*Nm*;
 - б) рассчитать и построить графики нормированных концентрационных профилей по глубине: N(x, y=10 мкм)/Nm; $N(x, y=a^{)}/Nm$; $N(x, y=\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm$.

Решение

Ниже приведен листинг решения задачи на Mathcad 2000 и графики распределений нормированного бокового концентрационного профиля (рис.4) и нормированных концентрационных профилей по глубине (рис.5).

a)

$$\theta := 10 \cdot \frac{\pi}{180}$$
 d := 4 \cdot 10^{-4} cm Q := 150 \cdot 6.25 \cdot 10^{12} cm^{-2}

 $Rp := 1.586 \times 10^{-5} cm \quad \Delta Rp := 4.99 \times 10^{-6} cm \quad \Delta Rt := 5.3 \times 10^{-6} cm$

$$\Delta R := \sqrt{\Delta R p^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta R t^2 \cdot \sin(\theta)^2}$$

$$Xm := Rp + 4 \cdot \Delta Rp$$

$$\Delta R't := \Delta R t \cdot \sin(\theta) \quad a'(x) := x \cdot \tan(\theta)$$

$$x := Rp + 0 \cdot \sqrt{2} \cdot \Delta Rp$$

$$y := (-1 \cdot 10^{-8}) \text{ cm} \cdot 10^{-10} \text{ cm} \cdot 2 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$$

$$Nm := \frac{Q}{\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \Delta R} \qquad N(x) := Nm \cdot e^{-\frac{(x - Rp \cos(\theta))^2}{2 \cdot \Delta R^2}}$$
$$Nf(x, y) := \frac{-N(x)}{2} \cdot erfc\left(\frac{y - a'(x)}{\sqrt{2} \cdot \Delta R't}\right)$$



Рис. 4. График распределения нормированного бокового концентрационного профиля при наклонной имплантации под углом 10° относительно нормали к кремниевой пластине ионов бора с энергией 50 кэВ и дозой 150 мкКл/см²

б)

$$\theta := 10 \cdot \frac{\pi}{180}$$
 $d := 4 \cdot 10^{-4}$ cm $Q := 150 \cdot 6.25 \cdot 10^{12}$ cm⁻²

$$Rp := 1.586 \times 10^{-5} \text{cm} \quad \Delta Rp := 4.99 \times 10^{-6} \text{cm} \quad \Delta Rt := 5.3 \times 10^{-6} \text{cm}$$
$$\Delta R := \sqrt{\Delta Rp^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2}\Delta Rt^2 \cdot \sin(\theta)^2}$$

 $Xm := Rp + 4 \cdot \Delta Rp$

$$\Delta \mathbf{R}'\mathbf{t} := \Delta \mathbf{R}\mathbf{t} \cdot \sin(\theta) \quad \mathbf{a}' := \mathbf{R}\mathbf{p} \cdot \cos(\theta) \cdot \tan(\theta)$$
$$\mathbf{x} := (0) \operatorname{cm}, 10^{-6} \operatorname{cm}. 2 \cdot 10^{-4} \operatorname{cm} \quad \mathbf{y}1 := -10 \cdot 10^{-4} \operatorname{cm} \quad \mathbf{y}2 := \mathbf{a}' \quad \mathbf{y}3 := \sqrt{2} \Delta \mathbf{R}'\mathbf{t}$$



Рис. 5. Графики распределений нормированных концентрационных профилей по глубине при наклонной имплантации под углом 10° относительно нормали к кремниевой пластине ионов бора с энергией 50 кэВ и дозой 150 мкКл/см²

- 2. Проводится наклонная имплантация под углом 40° относительно нормали к кремниевой пластине марки КЭФ2 ионами бора с энергией 60 кэВ и дозой 80 мкКл/см². На пластине предварительно сформирована защитная маска толщиной 2 мкм и при имплантации образуется теневой участок:
 - а) рассчитать глубины залегания p-n переходов при $y=a''-\sqrt{2}\cdot\Delta R_{\perp}$; y=a''; $y=a''+\sqrt{2}\Delta R_{\perp}$;
 - б) построить график распределения нормированного бокового концентрационного профиля *N*(*x*, *y*)/*Nm*;
 - в) рассчитать и построить графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x, y = a'' + \sqrt{2\Delta R_{\perp}})/Nm; N(x, y = a'')/Nm;$
 - г) построить график зависимости глубин залегания сформированных p-n переходов *x*_{*j*1,2}(*y*).

Решение

Ниже приведен листинг решения задачи на Mathcad 2000 и графики распределений двумерного бокового распределения примеси (рис. 6), нормированных концентрационных профилей по глубине (рис. 7) и графики зависимостей глубин залегания p-n переходов (рис. 8). а)

 $qe := 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot Kul$ $Kul \equiv A \cdot sec$ Ni := $\frac{1}{\text{qe} \cdot 1400 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{sec}} \cdot 2 \cdot \text{ohm} \cdot \text{cm}}$ $\theta := 40 \cdot \frac{\pi}{180}$ d := 2 \cdot 10^{-4} cm Q := 80 \cdot 6.25 \cdot 10^{12} cm^{-2} $Rp := 1.872 \times 10^{-5} cm \Delta Rp := 5.48877 \times 10^{-6} cm \Delta Rt := 6.03578 \times 10^{-6} cm$ $\Delta \mathbf{R} := \sqrt{\Delta \mathbf{R} \mathbf{p}^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{R} \mathbf{t}^2 \cdot \sin(\theta)^2}$ $\Delta \mathbf{R}' \mathbf{t} := \Delta \mathbf{R} \mathbf{t} \cdot \sin(\theta) \quad \mathbf{a}''(\mathbf{x}) := (\mathbf{x} + \mathbf{d}) \cdot \tan(\theta) \quad \mathbf{x} := \mathbf{R} \mathbf{p} \cdot \cos(\theta)$ $y_1(x) := a''(x) - \sqrt{2} \cdot \Delta R't \ y_2(x) := a''(x) \qquad y_3(x) := a''(x) + \sqrt{2} \cdot \Delta R't$ $xj1(x,y) := Rp \cdot \cos(\theta) - \Delta R \cdot \left| 2 \cdot \ln \left| \frac{Q \cdot \left[2 - \operatorname{erfc} \left[\frac{(y - a''(x))}{\sqrt{2} \cdot \Delta Rt} \right] \right]}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot 2}} \right|$ $xj2(x,y) := Rp \cdot \cos(\theta) + \Delta R \cdot \left| 2 \cdot \ln \left| \frac{Q \cdot \left[2 - erfc \left[\frac{(y - a''(\overline{x}))}{\sqrt{2} \cdot \Delta Rt} \right] \right]}{2 \cdot \sqrt{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac$

 $\begin{aligned} xj1(x,y1(x)) &= -5.843 \times 10^{-8} \text{m} & xj2(x,y1(x)) = 3.452 \times 10^{-7} \text{m} \\ xj1(x,y2(x)) &= -7.07 \times 10^{-8} \text{m} & xj2(x,y2(x)) = 3.575 \times 10^{-7} \text{m} \\ xj1(x,y3(x)) &= -7.643 \times 10^{-8} \text{m} & xj2(x,y3(x)) = 3.632 \times 10^{-7} \text{m} \end{aligned}$

б)

$$\begin{split} \theta &:= 10 \cdot \frac{\pi}{180} \quad d := 4 \cdot 10^{-4} \text{ cm} \qquad Q := 150 \cdot 6.25 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-2} \\ \text{Rp} &:= 1.586 \times 10^{-5} \text{ cm} \quad \Delta \text{Rp} := 4.99 \times 10^{-6} \text{ cm} \quad \Delta \text{Rt} := 5.3 \times 10^{-6} \text{ cm} \\ \Delta \text{R} := \sqrt{\Delta \text{Rp}^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta \text{Rt}^2 \cdot \sin(\theta)^2} \\ \Delta \text{R't} &:= \Delta \text{Rt} \cdot \sin(\theta) \quad a'(x) := x \cdot \tan(\theta) \quad a''(x) := (x + d) \cdot \tan(\theta) \\ \text{Nm} &:= \frac{Q}{\sqrt{2\pi} \cdot \Delta \text{R}} \qquad N(x) := \text{Nm} \cdot e^{-\frac{(x - \text{Rp} \cdot \cos(\theta))^2}{2 \cdot \Delta \text{R}^2}} \\ \text{Nf}(x, y) &:= \frac{N\left(x \cdot 10^{-7}\right)}{2} \cdot \left(2 - \text{erfc}\left(\frac{y \cdot 10^{-7} - a''\left(x \cdot 10^{-7}\right)}{\sqrt{2} \cdot \Delta \text{R't}}\right)\right) \cdot \text{Nm}^{-1} \\ x1 := 0 \cdot \text{m} \qquad x2 := 4 \cdot \text{m} \\ y1 := 6.5 \cdot \text{m} \qquad y2 := 8 \cdot \text{m} \end{split}$$

Nn := CreateMesh(Nf, x1, x2, y1, y2)



Nn

Рис.6. Двумерный график нормированного бокового распределения под краем защитной маски толщиной 2 мкм с образованием теневого участка при наклонной имплантации под углом 40° относительно нормали к поверхности кремниевой пластины ионами бора с энергией 60 кэВ и дозой 80 мкКл/см²

B)

$$\theta := 10 \cdot \frac{\pi}{180} \quad d := 4 \cdot 10^{-4} \text{cm} \quad Q := 150 \cdot 6.25 \cdot 10^{12} \text{cm}^{-2}$$

$$\text{Rp} := 1.586 \times 10^{-5} \text{cm} \quad \Delta \text{Rp} := 4.99 \times 10^{-6} \text{cm} \quad \Delta \text{Rt} := 5.3 \times 10^{-6} \text{cm}$$

$$\Delta \text{R} := \sqrt{\Delta \text{Rp}^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta \text{Rt}^2 \cdot \sin(\theta)^2}$$

$$\Delta \text{R't} := \Delta \text{Rt} \cdot \sin(\theta) \quad \text{a''} := (\text{Rp} \cdot \cos(\theta) + d) \cdot \tan(\theta)$$

$$Nm := \frac{Q}{\sqrt{2\pi} \cdot \Delta R} \qquad N(x) := Nm \cdot e^{-\frac{(x - Rp \cdot \cos(\theta))^2}{2 \cdot \Delta R^2}}$$
$$y1 := a'' + \sqrt{2} \Delta R't \qquad y2 := a''$$
$$Nf(x, y) := \frac{N(x)}{2} \cdot \left(2 - \operatorname{erfc}\left(\frac{y - a''}{\sqrt{2} \cdot \Delta R't}\right)\right)$$



Рис. 7. Графики распределений нормированных концентрационных профилей по глубине вблизи края защитной маски толщиной 2 мкм при наклонной имплантации под углом 40° относительно нормали с образованием теневого участка ионов бора с энергией 60 кэВ и дозой 80 мкКл/см²

r)
qe :=
$$1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \text{Kul Kul} = \text{A} \cdot \text{sec}$$

 $\theta := 40 \cdot \frac{\pi}{180}$ $d := 2 \cdot 10^{-4} \text{cm}$ $Q := 80 \cdot 6.25 \cdot 10^{12} \text{cm}^{-2}$
Rp := $1.872 \times 10^{-5} \text{cm} \Delta \text{Rp} := 5.48877 \times 10^{-6} \text{cm} \Delta \text{Rt} := 6.03578 \times 10^{-6} \text{cm}$
 $\Delta \text{R} := \sqrt{\Delta \text{Rp}^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta \text{Rt}^2 \cdot \sin(\theta)^2}$
 $\Delta \text{R't} := \Delta \text{Rt} \cdot \sin(\theta)$ $a'' := (\text{Rp} \cdot \cos(\theta) + d) \cdot \tan(\theta)$
Ni := $\frac{1}{qe \cdot 1400 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{sec}} \cdot 2 \cdot \text{ohm} \cdot \text{cm}}$ $y := (0) \text{cm}, 10^{-6} \text{cm}...2 \cdot 10^{-4} \text{cm}$
 $xj1(y) := \text{Rp} \cdot \cos(\theta) - \Delta \text{R} \cdot \sqrt{2 \cdot \ln \frac{Q \cdot \left[2 - \text{erfc}\left[\frac{(y-a'')}{\sqrt{2} \cdot \Delta \text{R} \cdot \text{Ni}}\right]\right]}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \Delta \text{R} \cdot \text{Ni}}}$
 $xj2(y) := \text{Rp} \cdot \cos(\theta) + \Delta \text{R} \cdot \sqrt{2 \cdot \ln \frac{Q \cdot \left[2 - \text{erfc}\left[\frac{(y-a'')}{\sqrt{2} \cdot \Delta \text{R} \cdot \text{Ni}}\right]\right]}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \Delta \text{R} \cdot \text{Ni}}}$



Рис. 8. Графики зависимости глубин залегания сформированных p-n переходов под краем защитной маски толщиной 2 мкм при наклонной имплантации с образованием теневого участка под углом 40° относительно нормали к подложке марки КЭФ2 ионами бора с энергией 60 кэВ и дозой 80 мкКл/см²

- 3. Исследовать зависимость глубины залегания сформированных p-n переходов *x_{j1,2}(y)* от угла падения относительно нормали к поверхности кремниевой пластины марки КДБ7 при имплантации под край окисной маски толщиной 3 мкм ионов фосфора с энергией 75 кэВ и дозой 120 мкКл/см².
- 4. Исследовать зависимость глубины залегания сформированных p-n переходов *x_{j1,2}(y)* от угла падения относительно нормали к поверхности кремниевой пластины n-типа с исходной концентрацией 5.10¹⁴ см⁻³ ионов бора с энергией 50 кэВ и дозой 200 мкКл/см², если около края защитной маски из окиси кремния толщиной 4 мкм образуется теневой участок.
- 5. При имплантации мышьяка под край окисной маски толщиной 2.5 мкм угол наклона потока ионов относительно нормали к поверхности кремниевой пластины марки КДБ4.5 составил 20°. Рассчитать и построить:
 - а) зависимость глубины залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов при внедрении ионов мышьяка с энергией 100 кэВ и дозой 10^{15} см⁻²;
 - б) графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x,y=5 \ MKM)/Nm; \ N(x,y=0)/Nm; \ N(x,y=\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm;$
 - в) график распределения нормированного бокового концентрационного профиля *N*(*x*=*const*,*y*)/*Nm*.
- 6. Проводится наклонная имплантация ионами сурьмы кремниевой подложки р-типа с удельной электропроводностью 0.2 Ом⁻¹·см⁻¹. Вблизи края защитной маски, получаемой термическим окислением в атмосфере водяного пара при температуре 1000 °С течение 30 минут, образуется теневой участок вследствие наклона пучка ионов относительно нормали к поверхности кремния под углом 30°. Энергия ионов сурьмы равна 90 кэВ, а доза имплантации - 10¹⁴ см⁻². Рассчитать и построить:
 - а) графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x,y=0 \ M\kappa M)/Nm; \ N(x,y=a'')/Nm; \ N(x,y=a''+\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm;$
 - б) рассчитать и построить график распределения нормированного бокового концентрационного профиля *N*(*x*=*const*,*y*)/*Nm*;
 - в) зависимость *x*_{*jl*,2}(*y*) глубины залегания сформированных p-n переходов.

Вопросы

- 1. Записать распределение примеси под краем защитной маски, если профиль наклонно имплантируемых примесей по глубине описывается усеченной гауссианой.
- 2. Найти аналитическую зависимость глубин залегания *x*_{*j*1,2}(*y*) сформированных р-п переходов в случае описания по глубине наклонно имплантируемых примесей усеченной гауссианой.
- 3. Записать распределение примеси в области теневого участка у края защитной маски, если профиль наклонно имплантируемых примесей по глубине описывается:

а) неусеченной гауссианой;

б) усеченной гауссианой.

4. Записать распределение примеси в области теневого участка у края защитной маски, если профиль наклонно имплантируемых примесей по глубине описывается:

а) неусеченной гауссианой с учетом эффекта каналирования;

б) усеченной гауссианой с учетом эффекта каналирования.

- 5. В условиях вопроса 3 найти аналитическую зависимость глубин залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов.
- 6. В условиях вопроса 4 найти аналитическую зависимость глубин залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов.
- 7. Нарисовать и сравнить два профиля распределения примесей под краем защитной маски, если профили наклонно имплантируемых примесей по глубине описываются неусеченными гауссианами при $DR_{p1} < DR_{p2}$ и $DR_{p^{-1}} < DR_{p^{-2}}$.

2.2. Распределение примесей при наклонной имплантации

с учетом бокового рассеяния под края щели в защитной маске

При наклонной имплантации через щель в защитной маске (рис. 9) под углом *q* относительно нормали к поверхности у правого края щели внедрение ионов происходит под защитный слой, а у левого края щели образуется теневая область.

Учитывая результаты, полученные в п. 2.1, можно построить распределение примесей с учетом бокового рассеяния ионов, наклонно имплантированных через щель в защитной маске размером 2*a*:

$$N(x, y) = \frac{N(x)}{2} \left[erfc \frac{a'-y}{\sqrt{2}\Delta R'_{\perp}} - erfc \frac{a''-y}{\sqrt{2}\Delta R'_{\perp}} \right], \qquad (2.5)$$

ГДЕ $\Delta R_{\perp} = \Delta R_{\perp} \sin q$; a' = -a + (d + x)tgq; a'' = a + xtgq.

Если наклонно имплантируемый профиль описывается по глубине усеченной гауссианой (1.2), то распределение примесей с учетом бокового рассеяния [1] будет иметь вид

$$N(x,y) = \frac{Q}{2\sqrt{\frac{p}{2}}\Delta R(1+erf\frac{R_p\cos q}{\sqrt{2}\Delta R})} \cdot e^{-\frac{(x-R_p\cos q)^2}{2\Delta R^2}} \left[erfc\frac{a'-y}{\sqrt{2}\Delta R'_{\perp}} - erfc\frac{a''-y}{\sqrt{2}\Delta R'_{\perp}}\right].$$
 (2.6)



Рис. 9. Формирование нормированных профилей распределения примесей при наклонной имплантации через щель шириной 2*a* в защитной маске

В случае легирования подложки с противоположным типом проводимости и исходной концентрацией примеси N_{ucx} из условия $N(x_{j1,2},y)=N_{ucx}$ можно получить аналитическую зависимость для глубин залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов

$$x_{j1,2}(y) = R_p \cos q \pm \Delta R_{\gamma} \left[2 \ln \frac{Q \left[erfc \frac{a'-y}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}'} - erfc \frac{a''-y}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}'} \right]}{2\sqrt{\frac{p}{2}} \Delta R (1 + erf \frac{R_p \cos q}{\sqrt{2}\Delta R}) N_{ucx}} \right].$$
(2.7)

Задания

- Проводится наклонная имплантация сурьмы в щель шириной 5 мкм в окисном слое толщиной 1.5 мкм. Угол наклона ионного пучка составляет 10° относительно нормали к поверхности кремниевой пластины р-типа с удельным сопротивлением 5.10¹⁴ см⁻³. Энергия ионов сурьмы равна 100 кэВ, а доза – 10¹⁴ см⁻². Рассчитать и построить:
 - а) распределение нормированной концентрации сурьмы при заданной глубине залегания примесного слоя *N*(*x*=*const*, *y*)/*Nm*;
 - б) графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x,y=0 \ M\kappa M)/Nm; N(x, y = a' + \sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm; N(x,y=a')/Nm;$
 - в) зависимость x_{i1,2}(у) глубины залегания сформированных p-n переходов.

Решение

Ниже приведен листинг решения задачи на Mathcad 2000 и графики распределений нормированной концентрации под краем щели в защитной маске (рис. 10, 11) и по глубине (рис. 12).



Рис.10. График распределения нормированного бокового профиля вблизи края маски толщиной 1.5 мкм при наклонной имплантации в щель шириной 5 мкм под углом 10° к нормали с образованием теневого участка ионов сурьмы с энергией 100 кэВ и дозой 10¹⁴ см⁻²



Рис.10. График распределения нормированного бокового профиля вблизи края маски толщиной 1.5 мкм при наклонной имплантации в щель шириной 5 мкм под углом 10° относительно нормали сурьмы с энергией 100 кэВ и дозой 10¹⁴ см⁻²

б)

Ni := $5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ $\theta := 10 \cdot \frac{\pi}{180}$ $d := 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$ $Q := 1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ $a := 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$ Rp := $5.805 \times 10^{-6} \text{ cm}$ $\Delta \text{Rp} := 1.825 \times 10^{-6} \text{ cm}$ $\Delta \text{Rt} := 1.194 \times 10^{-6} \text{ cm}$ $\Delta \text{R} := \sqrt{\Delta \text{Rp}^2 \cdot \cos(\theta)^2 + \frac{1}{2} \Delta \text{Rt}^2 \cdot \sin(\theta)^2}$ $\Delta \text{R't} := \Delta \text{Rt} \cdot \sin(\theta)$ $a'(x) := -a + (x + d) \cdot \tan(\theta)$ $a''(x) := a + x \cdot \tan(\theta)$

$$x := (0) \text{ cm}, 10^{\circ} \text{ cm}.. 0.75 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$y_1 := 0$$
 $y_2(x) := a'(x)$ $y_3(x) := a'(x) + \sqrt{2} \cdot \Delta R' t$

$$Nm := \frac{Q}{\sqrt{2\pi} \cdot \Delta R} \qquad \qquad -\frac{\left(x - Rp \cdot \cos(\theta)\right)^2}{2 \cdot \Delta R^2}$$
$$N(x) := Nm \cdot e^{-\frac{\left(x - Rp \cdot \cos(\theta)\right)^2}{2 \cdot \Delta R^2}}$$
$$Nf(x, y) := \frac{N(x)}{2} \cdot \left(\operatorname{erfc}\left(\frac{a'(x) - y}{\sqrt{2} \cdot \Delta R't}\right) - \operatorname{erfc}\left(\frac{a''(x) - y}{\sqrt{2} \cdot \Delta R't}\right) \right)$$



- Рис. 12. Графики распределений нормированных концентрационных профилей по глубине вблизи края защитной маски толщиной 1.5 мкм при наклонной имплантации в щель шириной 5 мкм под углом 10° относительно нормали ионов сурьмы с энергией 100 кэВ и дозой 10¹⁴ см⁻²
- 2. На кремниевой пластине марки КДБ7 во влажной атмосфере термически наращивается слой окисла при температуре 900 °C в течение 50 минут, а затем вытравливается щель шириной 4 мкм, в которую проводится наклонная имплантация ионов мышьяка под углом 15° относительно нормали к поверхности кремния. С учетом бокового рассеяния под края защитной маски найти:
- а) распределение нормированной концентрации мышьяка N(x=const,y)/Nm при энергии ионов 90 кэВ и дозе имплантации 100 мкКл/см²;
- б) графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x,y=0 \ M\kappa M)/Nm; \ N(x,y=a')/Nm; \ N(x,y=a'')/Nm; \ N(x,y=a''+\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm;$ $N(x, y = a'+\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm; \ N(x, y = \pm a'')/Nm,$ если энергия ионов мышьяка была 100кэВ, а доза имплантации составила 200 мкКл/см²;
- в) зависимость от энергии ионов мышьяка в диапазоне 50÷120 кэВ глубин залегания примесного слоя с концентрацией 10¹⁷ см⁻³ на границе у=а, если доза имплантации составила 200 мкКл/см²;
- г) линии равной концентрации 10¹⁶ см⁻³ и 10¹⁷ см⁻³ внедренного мышьяка при энергии 90 кэВ и дозе имплантации 100 мкКл/см²;
- д) зависимость $x_{jl,2}(y)$ глубин залегания сформированных p-n переходов при следующем режиме имплантации: E=100 кэВ, Q=150 мкКл/см².

- 3. Проводится наклонная имплантация ионами бора кремниевой пластины n-типа с удельной электропроводностью 0.2 Ом⁻¹·см⁻¹ через щель размером 2×2 мкм в защитной маске толщиной 1.5 мкм. Ионы бора с энергией 75 кэВ и дозой 150 мкКл/см² внедряются под углом 25° относительно нормали к кремниевой подложке. Для того чтобы избежать формирования теневого участка, легирование проводится в два этапа с равными дозами имплантации и поворотом пластины на 180°. Рассчитать и построить:
 - а) график распределения нормированного бокового концентрационного профиля *N*(*x*=*const*,*y*)/*Nm*;
 - б) графики нормированных концентрационных профилей по глубине: $N(x,y=0 M \kappa M)/Nm; N(x,y=a')/Nm; N(x,y=a'')/Nm; N(x, y = a''+\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm;$ $N(x, y = -a''+\sqrt{2}\Delta R_{\perp})/Nm; N(x, y = \pm a)/Nm;$
 - в) линии равной концентрации N_m , 10^{17} см⁻³, 10^{16} см⁻³;
 - г) зависимость $x_{i1,2}(y)$ глубин залегания сформированных p-n переходов.

Вопросы

- 1. Как изменится распределение (2.6) при учете эффекта каналирования?
- 2. Записать распределение примеси при наклонной имплантации через щель шириной 2*a* в защитной маске с учетом бокового рассеяния и эффекта каналирования, если профиль по глубине описывается неусеченной гауссианой.
- 3. В условиях вопроса 2 найти аналитическую зависимость глубин залегания $x_{j1,2}(y)$ сформированных p-n переходов.
- 4. Нарисовать и сравнить два профиля ионно-имплантированных примесей при наклонной имплантации, если профили внедренных примесей имеют следующие параметры: $DR_{p1} > DR_{p2}$ и $DR_{p^{-1}} > DR_{p^{-2}}$.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Асессоров В.В. Математические модели распределений ионноимплантированных примесей / В.В. Асессоров. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. – 100 с.
- Бубенников А.Н. Физико-технологическое проектирование биполярных элементов кремниевых БИС / А.Н. Бубенников, А.Д. Садовников. – М.: Радио и связь, 1991. – 288 с.
- Красников Г.Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов / Г.Я. Красников: В 2-х кн. – М.: Техносфера, 2002. - Ч.1. -416 с.
- 4. МОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов/ Под ред. П.Антонетти, Д.Антониадиса, Д. Даттона, У. Оулдхема. М.: Радио и связь,
- 5. Технология СБИС / Под ред. С. Зи : В 2-х кн. М.: Мир, 1986. Кн.1. 404 с.; Кн.2. – 416 с.

Аппроксимирующие полиномы для расчета параметров распределений основных примесей в кремнии:

- для ионов бора

$$lg R_{p} = 0,613 + 0,8786 \cdot lg E + 0,0773 \cdot (lg E)^{2} - 0,0262 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{p} = 0,482 + 0,8594 \cdot lg E - 0,0616 \cdot (lg E)^{2} - 0,0135 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{\perp} = 0,506 + 0,556 \cdot lg E + 0,239 \cdot (lg E)^{2} - 0,081 \cdot (lg E)^{3};$$

- для ионов фосфора

$$lg R_{p} = 0,682 + 0,1861 \cdot lg E + 0,3769 \cdot (lg E)^{2} - 0,0581 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{p} = 0,401 + 0,2209 \cdot lg E + 0,3478 \cdot (lg E)^{2} - 0,0711 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{\perp} = 0,205 + 0,537 \cdot lg E + 0,051 \cdot (lg E)^{2} + 0,015 \cdot (lg E)^{3};$$

- для ионов мышьяка

$$lg R_{p} = 0,585 + 0,4843 \cdot lg E + 0,0299 \cdot (lg E)^{2} + 0,0174 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{p} = 0,192 + 0,3995 \cdot lg E + 0,109 \cdot (lg E)^{2} - 0,0074 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{\perp} = 0,042 + 0,553 \cdot lg E - 0,042 \cdot (lg E)^{2} + 0,029 \cdot (lg E)^{3};$$

- для ионов сурьмы

$$lg R_{p} = 0,597 + 0,606 \cdot lg E - 0,0767 \cdot (lg E)^{2} + 0,0327 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{p} = 0,104 + 0,4905 \cdot lg E + 0,0103 \cdot (lg E)^{2} + 0,0124 \cdot (lg E)^{3};$$

$$lg \Delta R_{\perp} = -0,047 + 0,629 \cdot lg E - 0,096 \cdot (lg E)^{2} + 0,032 \cdot (lg E)^{3}.$$

Здесь энергия задается в килоэлектронвольтах, а значения нормальных пробегов и среднеквадратичных отклонений получаются в нанометрах.

Составили: Бормонтов Евгений Николаевич Быкадорова Галина Владимировна Григорьев Роман Григорьевич Науч. ред.: Петров Борис Константинович

Редактор: Бунина Т.Д.